

Artikel-Nr. und/oder Bezeichnung: _____

BASISINFORMATIONEN

Leiterplatten-Typ: _____ Lagenanzahl: _____ IPC-Klasse: _____

Basismaterial: _____ Materialdicke (in mm): _____

Kupferstärke (in μm): _____ (Außenlagen) _____ (Innenlagen) E-Test: _____ (ab 2 Lagen inkl.)

Lagenaufbau: _____ Definierte Impedanzen: _____

Finish/Oberfläche: _____

DRUCKINFORMATIONEN

Positionsdruck: TOP-Seite BOT-Seite Farbe: _____

Lötstopplack: TOP-Seite BOT-Seite Farbe: _____

Peeling: TOP-Seite BOT-Seite Typ: _____

Carbondruck: TOP-Seite BOT-Seite

Kennzeichnungen: UL-Zeichen: _____

RoHS-Zeichen: _____

DateCode: _____

MECHANIKINFORMATIONEN

Min. Kupfer-Abstände (in mm): _____ Min. Bohr- \varnothing (in mm): _____

Min. Kupfer-Breiten (in mm): _____ Via-Typ: _____

Z-Achsenfräsen	Anfasung	Blind-Vias	Einpresstechnik
Senkungen	Sprungritzen	Buried-Vias	Plating (Kanten, Schlitze)

Maße Einzelplatine (in mm): _____ x _____ Kontur Einzelplatine: _____

Maße Nutzen (in mm): _____ x _____ Anzahl Einzelplatten/Nutzen: _____

Nutzenaufbau: Ritzen gefräst an Stegen Summe Fräsweg in mm: _____

No-X-Out Min. Fräser- \varnothing in mm: _____

ZUSATZINFORMATIONEN